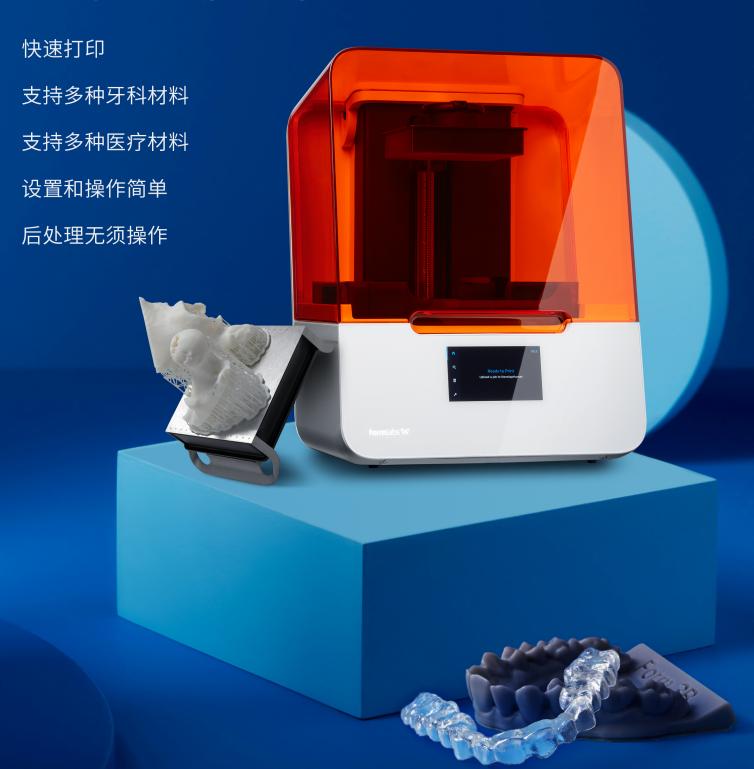
Form 3B+

数字化转型易如反掌



技术参数 Form 3B+

 打印尺寸(寛×深×高): 145×145×185mm 打印机尺寸(寛×深×高): 405 × 375 × 530mm 重量: 17.5KG 标准树脂: Black、Clear、Color、Draft、Grey、Grey Pro、White Tough Resin和Durable Resin: Durable、Tough 1500、Tough 2000 Flexible Resin和Elastic Resin: Elastic 50A、Flexible 80A Rigid Resin: Rigid 10K、Rigid 4000 珠宝树脂: ESD、High Temp 牙科树脂: Custom Tray、Dental LT、IBT、Model、Surgical Guide 医疗树脂: BioMed Amber、BioMed Clear 打印技术 Low Force Stereolithography (LFS)™ XY分辨率 25μm 激光光斑尺寸 85μm 激光光斑尺寸 85μm 激光光斑尺寸 85μm 激光光斑尺寸 85μm 测能进料系统 自动 树脂造料系统 自动 树脂造科系统 自动 树脂造科系统 自动 村脂造科系统 自动 地方温度 自动加热至35°C 自动控温 操作环境 18−28°C 电源 电源要求 100-240V AC 2.5A,50/60 Hz 220 W 数光参数 Class 1 Laser Product 85micron(0.0033 in)laser spot 405nm wavelength 250mW power 连接 WiFi、以太网、USB 触摸屏 5.5英广帕摸屏1280x720像素 Mac OS X 10.10 and up OpenGL 2.1 4GB RAM 软件 切片软件 PreForm(自动切片、一键生成支撑) STL、OBJ、Form 		
重量: 17.5KG 标准树脂: Black、Clear、Color、Draft、Grey、Grey Pro、White Tough Resin和Durable Resin: Durable、Tough 1500、Tough 2000 Flexible Resin和Elastic Resin: Elastic 50A、Flexible 80A Rigid Resin: Rigid 10K、Rigid 4000 珠宝树脂: Castable Wax、Castable Wax 40 专业树脂: ESD、High Temp 牙科树脂: Custom Tray、Dental LT、IBT、Model、Surgical Guide 医疗树脂: BioMed Amber、BioMed Clear 打印技术 Low Force Stereolithography (LFS)™ X/分辨率 25μm 激光光功率 250W 打印层度 25-300um 树脂进料系统 自动 树脂盒个数 1个 支撑 自动生成,轻触移除 内部温度 自动加热至35°C 温度控制 自动控温 操作环境 18-28°C 电源要求 100-240V AC 2.5A,50/60 Hz フッ率 220 W 浙光参数 Class 1 Laser Product 85micron(0.0033 in)laser spot 405nm wavelength 250mW power 连接 Wifi、以太网、USB 融撲屏 5.5英寸触摸屏1280x720像素 Mac OS X 10.10 and up OpenGL 2.1 4GB RAM 如片软件 PreForm(自动切片、一键生成支撑)	尺寸	打印尺寸(宽×深×高): 145×145×185mm
标准树脂: Black、Clear、Color、Draft、Grey、Grey Pro、White Tough Resin和Durable Resin: Durable、Tough 1500、Tough 2000 Flexible Resin和Elastic Resin: Elastic 50A、Flexible 80A Rigid Resin: Rigid 10K、Rigid 4000 珠宝树脂: Castable Wax、Castable Wax 40 专业树脂: ESD、High Temp 牙科树脂: Custom Tray、Dental LT、IBT、Model、Surgical Guide 医疗树脂: BioMed Amber、BioMed Clear 打印技术 Low Force Stereolithography (LFS)™ XY分辨率 25μm 激光光斑尺寸 85um 激光光斑尺寸 85um 激光光斑平 250W 打印层度 25-300um 树脂造科系统 自动 树脂造合个数 1个 支撑 自动生成,轻触移除 内部温度 自动加热至35°C 温度控制 自动控温 操作环境 18-28°C 电源要求 100-240V AC 2.5A,50/60 Hz 220 W 漱光参数 Class 1 Laser Product 85micron(0.0033 in)laser spot 405nm wavelength 250mW power 近接 WiFi、以太网、USB 触摸屏 5.5英寸触摸屏1280x720像素 操作系统要求 Mac OS X 10.10 and up OpenGL 2.1 4GB RAM 软件 切片软件 PreForm(自动切片、一键生成支撑)		打印机尺寸(宽×深×高): 405 × 375 × 530mm
Tough Resin和Durable Resin: Durable、Tough 1500、Tough 2000 Flexible Resin和Elastic Resin: Elastic 50A、Flexible 80A Rigid Resin: Rigid 10K、Rigid 4000 材料 珠宝树脂: Castable Wax、Castable Wax 40 专业树脂: ESD、High Temp 牙科树脂: Custom Tray、Dental LT、IBT、Model、Surgical Guide 医疗树脂: BioMed Amber、BioMed Clear 打印技术 Low Force Stereolithography (LFS)™ XY分辨率 25μm 激光光斑尺寸 85um 激光光斑尺寸 85um 激光功率 2550W 打印层度 25-300um 材脂溢料系统 自动 材脂溢料系统 自动 材脂溢料系统 自动 材脂溢性系统 自动 对脂溢度 自动加热至35℃ 温度控制 自动控温 操作环境 18-28°C 电源要求 100-240V AC 2.5A,50/60 Hz 功率 220 W 打印机 控制 激光参数 Class 1 Laser Product 85micron(0.0033 in)laser spot 405nm wavelength 250mW power 连接 WiFi、以太网、USB 航漢屏 5.5英寸触摸屏1280x720像素 操作系统要求 Mac OS X 10.10 and up OpenGL 2.1 4GB RAM 如 件		重 量: 17.5KG
XY分辨率 25μm 激光光斑尺寸 85um 激光功率 250W 打印层度 25-300um 付加层度 25-300um 付加层度 25-300um 付加层度 25-300um 付加层本 1个 支撑 自动生成,轻触移除 自动生成,轻触移除 自动性温 操作环境 18-28°C 温度控制 自动控温 操作环境 18-28°C 电源要求 100-240V AC 2.5A,50/60 Hz 220 W 220 W 220 W 2405nm wavelength 250mW power 25接 WiFi、以太网、USB 25.5英寸触摸屏1280x720像素 Mac OS X 10.10 and up OpenGL 2.1 4GB RAM 切片软件 PreForm(自动切片、一键生成支撑)		Tough Resin和Durable Resin: Durable、Tough 1500、Tough 2000 Flexible Resin和Elastic Resin: Elastic 50A、Flexible 80A Rigid Resin: Rigid 10K、Rigid 4000 珠宝树脂: Castable Wax、Castable Wax 40 专业树脂: ESD、High Temp 牙科树脂: Custom Tray、Dental LT、IBT、Model、Surgical Guide
型 物	技 术	XY分辨率 25μm 激光光斑尺寸 85um 激光功率 250W 打印层度 25-300um 树脂进料系统 自动 树脂盒个数 1个 支撑 自动生成,轻触移除 内部温度 自动加热至35℃ 温度控制 自动控温
接接 WiFi、以太网、USB 触摸屏 5.5英寸触摸屏1280x720像素 操作系统要求 Mac OS X 10.10 and up OpenGL 2.1 4GB RAM 切片软件 PreForm(自动切片、一键生成支撑)	电 源	
		405nm wavelength 250mW power 连接 WiFi、以太网、USB 触摸屏 5.5英寸触摸屏1280x720像素 操作系统要求 Mac OS X 10.10 and up OpenGL 2.1
	软 件	,

上海志瞳智能科技有限公司

● 电话: 400-838-1100● 网址: www.f3dp.cn

地址:上海市杨浦区国权北路1600号B5座4层(总部) 西安市高新区高新二路西安市众创示范街区A104 深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋A座1层